

上海维科精密模塑股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026 -002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司可转债路演的全体投资者
时间	2026年6月25日 14:00-16:00
地点	全景网（ https://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：TAN YAN LAI（陈燕来）先生 董事、总经理：张茵女士 副总经理、财务总监兼董事会秘书：黄琪先生 保荐代表人：张翼先生、贾瑞兴先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、陈总好，维科精密的市值战略是怎样计划的？</p> <p>答：公司市值管理的核心逻辑是立足长期经营基本面，以扎实的主业发展夯实内在价值：一方面深耕汽车电子精密零部件主业，持续加大研发创新力度、拓展海内外优质客户、推进半导体等新业务布局打造增长第二曲线，稳步提升经营质量与盈利水平；另一方面严格恪守信息披露规范，通过定期报告、投资者交流等渠道做好透明化的投资者沟通工作，向资本市场传递公司发展战略与经营进展，维护全体股东的长期利益，推动公司市值与内在价值长期匹配、稳健成长。</p> <p>感谢您关注公司。</p> <p>2、张总您好！7月21日公司将迎来占总股本75共计1.04亿股的解禁，请问您和陈总是否有减持计划还是说未来半年无此想法？谢谢</p> <p>答：您好，未来半年无减持计划，感谢您的关注。</p>

3、是否和特斯拉有深度合作？

答：您好，请关注公司公告，谢谢。

4、投向半导体零件，具体有哪些半导体产品？后期效益如何？

答：维科精密在半导体领域的主要产品包括半导体功率模块部件侧框（现有产品）、半导体封装引线框架（新产品）及半导体封装引线框架桥接片（新产品），后期效益具体数据请参见公司公告。

5、请问是否有通过拓普集团向特斯拉人形机器人供货？

答：公司目前尚未获取拓普集团量产产品订单，谢谢。

6、IGBT功率模块封装相关产品量产和市场导入进度如何？

答：公司相关侧框类产品（无论是IGBT还是碳化硅）已进入批量供货阶段，并持续配合客户进行产品迭代和产能保障。引线框架、桥接片等新产品正在按照客户验证、样件测试、小批量导入和量产爬坡的路径推进。

公司会优先保障产品质量、交付稳定性和客户认证节奏，不会为了追求短期放量而牺牲车规级和功率半导体客户对可靠性的要求。

7、泰国生产基地投产进度与预期产能收益如何？

答：泰国生产基地于2025年9月顺利获得IATF16949:2016质量管理体系认证，并于2025年底正式启动小批量生产，直接辐射东南亚、北美及欧洲市场，泰国生产基地预期产能收益以公告为准，谢谢。

8、半导体侧框产品近年销量及毛利率表现怎样？

答：公司积极推进半导体功率模块产品业务，销售实现稳步增长，具体产品销量及毛利率数据以公告为准，感谢您关注。

9、公司在汽车产业链中的主要客户有哪些？是否存在单一客户依赖？

答：维科精密的主要客户涵盖了联合电子、博世、博格华纳等全球顶尖Tier 1供应商，公司不存在严重的单一客户依赖。

公司直接客户包括联合电子、博世、博格华纳等。终端覆盖蔚来、理想、小鹏、小米、比亚迪等国内主流车企及BBA等国际品牌。

公司通过开拓新客户和新项目，有效稀释了头部客户占比，降低了经营风险。

海外业务与非汽车连接器业务的增长进一步平衡了公司的收入结构。非汽车领域与泰科、安费诺等深度合作，2025年该板块收入同比增长11.98%。

10、募投项目投产后，对产能和ROE会产生怎样影响？

答：募投项目建成后，将增强公司在半导体功率模块精密零部件和海外汽车电子精密零部件领域的供给能力，有利于优化产品结构和客户结构。随着产能逐步释放，项目有望提升公司长期盈利能力。

短期看，项目建设和爬坡阶段会带来折旧摊销、人员投入和运营准备成本，对利润率和ROE可能存在阶段性影响。中长期看，若订单导入和产能利用率达到预期，将有助于改善公司资产回报水平。

11、维科精密发展历程关键节点有哪些？

答：公司发展关键节点包括：公司成立（1999年）、拓展连接器业务（2001年）、业务聚焦汽车电子（2008年）、股份制改造（2021年）、创业板上市（2023年），逐步成长为以汽车电子精密零部件为核心业务的高新技术企业。

12、目前公司经营层面主要存在哪些发展风险？

答：公司主要产品为汽车电子产品，属于汽车零部件行业。公司在经营层面面临的风险包括宏观经济及下游行业波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧的风险、下游市场较为集中的风险等。

针对上述经营风险，公司采取了相应的风险防范措施，如公司在质量控制、技术服务、产品交付进度等方面不断优化，持续提升综合服务能力，提高客户黏性；公司加大新客户的挖掘，不断扩大客户覆盖面；公司通过建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施，降低原材料价格波动的影响等。

此外，公司通过实施本次募投项目，将进一步提升公司在半导体领域的竞争力、优化产品结构。半导体核心精密零部件产品有望成为公司业务增长新引擎、构筑第二增长曲线，持续提升公司抗风险能力。

13、本次可转债募集资金主要投向哪些项目？建设周期多久？

答：本次可转债募集资金主要投向半导体零部件生产基地建设项目、泰国生产基地建设项目以及补充流动资金。半导体项目重点围绕功率模块精密零部件产能建设，泰国项目重点提升海外汽车电子精密零部件供应能力。

相关项目建设周期、投资金额、产能规划和效益测算已在募集说明书等文件中披露。公司将严格按照募集资金管理制度规范使用募集资金，保障项目有序推进。

14、2026年一季度扣非净利润增长24.03%，主要驱动因素是什么？

答：一季度扣非净利润实现较快增长，主要来自三个方面：一是公司持续优化产品结构，高附加值产品、新能源相关产品以及半导体精密零部件业务贡献有所提升；二是公司持续推进精益生产、自动化改造和成本管控，运营效率改善对利润形成支撑；三是海外客户和重点项目稳步推进，订单交付节奏保持较好状态。

15、公司汽车电子与半导体业务营收占比变化如何？

答：目前公司营收仍然以汽车电子精密零部件为主，通过本次募投项目的实施，能够有效增强公司在功率半导体领域的竞争力，功率半导体零部件相关产品有望成为公司业务增长新引擎，构筑第二增长曲线，持续提升功率半导体零部件业务的收入贡献水平。功率半导体零部件除新能源汽车外，在风能、光伏、储能、工业控制、智能制造等领域均有广泛的应用前景，谢谢。

16、非汽车连接器业务增长情况如何？

答：非汽车连接器及零部件业务是公司多元化发展的组成部分，主要面向消费电子、通信、工业等领域，客户包括泰科电子、安费诺等国际连接器厂商。该业务占公司整体收入比例相对不高，但有助于丰富应用场景和客户结构。

公司将继续依托精密模具、注塑、冲压和自动化能力，提升非汽车连接器产品的技术含量和交付效率，同时坚持资源投入与战略主线相匹配。

17、半导体业务的目标客户群是哪些？

答：维科精密半导体业务的目标客户群主要聚焦于新能源汽车功率模块封装领域的行业龙头，包括芯联集成、上汽英飞凌、中车半导体、臻驱科技等知名企业。

18、近三年营收、归母净利润同比增长情况是多少？

答：公司2023年-2025年营收增长率分别为：7.33%、11.13%、

14.19%；归母净利润增长率分别是-5.01%、-29.44%、18.86%。

19、可转债募投项目分别投向哪些领域？

答：本次可转债募集资金主要投向半导体零部件生产基地建设项目、泰国生产基地建设项目以及补充流动资金。半导体项目重点围绕功率模块精密零部件产能建设，泰国项目重点提升海外汽车电子精密零部件供应能力。

20、驱动公司2025年营收和净利润双增长的核心因素是什么？

答：维科精密2025年营收与净利润的双增长，核心驱动力在于新能源汽车电控系统需求的持续放量、半导体功率模块业务的成功开拓，以及泰国工厂全球化布局的初步投产。

其中，新能源汽车产品需求的稳步增长带动了公司整体营收规模的扩张。2025年实现营业收入9.63亿元，同比增长14.19%。受益于新能源电控系统产品的放量，扣非后归母净利润达到5,168.60万元，同比大增40.00%，显示产品结构优化带来的盈利质量提升。

“第二增长曲线”半导体业务发力，半导体功率模块封装业务的产业化进程加快，贡献了新的利润增长点。公司2025年积极推进半导体侧框及引线框架业务，并与芯联集成签署战略合作协议。相关新产品已在2025年实现小批量供货。

此外，泰国工厂的顺利投产增强了海外市场的响应能力与抗风险能力。泰国生产基地于2025年9月获得IATF16949质量认证，并于2025年底正式启动小批量生产，就近配套博世等全球Tier 1客户，支撑业绩持续增长。

21、是否计划通过并购快速切入半导体、人形机器人或自动驾驶？

答：公司现阶段更强调围绕主业能力的内生式发展，通过客户合作、研发投入和募投项目建设拓展半导体精密零部件等新业务。对于人形机器人、自动驾驶等方向，公司会基于既有精密制造能力进行审慎研究和技术储备。

外延并购需要充分评估战略协同、估值风险、整合难度和对股东回报的影响。公司暂无应披露而未披露的并购重组计划。

22、面对铜、塑胶粒等原材料波动，有哪些成本控制和套保措施？

答：公司通过多种方式应对原材料波动：与核心供应商保持长期合作，优化采购节奏；与客户就部分产品建立价格协商或联动机制；推进原材料国产替代和供应商多元化；通过工艺优化、良率提升和材料利用率提升降低单位成本。

对于金融套保，公司将坚持与真实业务规模相匹配的原则，审慎使用相关工具，不进行投机交易。

23、2026年研发费用预算和重点投向是什么？

答：公司将保持与业务规模和战略方向相匹配的研发投入。研发重点包括新能源汽车电子精密零部件、功率半导体封装精密零部件、高端模具与自动化产线、传感器相关零部件、精密注塑和嵌件注塑工艺升级等。

公司不会简单以费用率作为唯一目标，更关注研发项目与客户需求、量产转化和长期竞争壁垒之间的匹配。

24、请问控股股东与高管是否参与可转债配售？

答：控股股东与高管可参与可转债配售，具体配售的结果请关注后续公告。

25、各细分产品板块毛利率存在哪些差异？

答：公司产品主要为汽车电子精密零部件和非汽车连接器及零

部件，细分产品有动力系统零部件、底盘系统零部件、非汽车连接器及零部件、汽车连接器及零部件等。各细分产品毛利率的差异受到技术工艺要求、下游应用场景、客户结构、原材料价格波动等多重因素的影响。各细分产品的毛利率数据以公司公告为准，感谢您关注。

26、半导体业务目前进展如何？与芯联集成合作聚焦哪些领域？

答：半导体精密零部件是公司重点培育的第二增长曲线。公司围绕IGBT、碳化硅等功率模块封装环节，推进侧框、引线框架、桥接片等精密零部件研发和产业化。相关产品对材料、尺寸精度、稳定性和批量一致性要求较高，与公司长期积累的精密制造能力高度相关。

与芯联集成的合作主要聚焦功率模块封装相关精密零部件。双方通过长期合作机制，推动产品验证、产能建设和交付保障。本次可转债募集资金项目的进展以双方协议约定及公司公告披露为准。

27、公司的“平台化产品策略”具有什么优势？

答：维科精密的“平台化产品策略”核心优势在于通过极高的产品通用性实现跨车型、跨客户的规模效应，从而显著摊薄研发成本并大幅提升公司的整体盈利空间。

平台化产品可供不同整车厂选用并配备在不同车型上，通过大批量生产有效降低单位制造及研发成本。平台化策略降低了对特定单一客户的定制化依赖，助力公司拓展更广泛的终端品牌。模块化的技术底座缩短了新产品的开发周期，使公司能快速切入半导体封装等高附加值赛道。

28、公司为什么要建设泰国生产基地？有何战略意义？

答：维科精密建设泰国生产基地旨在通过全球化布局有效规避国际贸易摩擦风险，并就近配套博世等全球Tier 1客户。

泰国生产基地于2025年9月 顺利获得IATF16949:2016质量管理体系认证，标志着其具备了向全球汽车客户供货的资质，并于2025年底正式启动小批量生产，直接辐射东南亚、北美及欧洲市场。公司利用现有国际客户资源积极拓展东南亚市场。拟发行的可转债，募集资金明确投向泰国生产基地建设项目，旨在通过“海外制造”进一步提升国际市场占有率。

29、公司前五大核心客户分别为哪些企业？

答：公司前五大客户分别是联合电子、博世集团、博格华纳、泰科电子、博世华域转向。

30、公司近年研发投入金额与研发费用率是多少？

答：公司近两年的研发投入金额分别为5,678.96万元和5,577.08万元，占比分别为6.74%和5.79%。

31、维科精密的“第二增长曲线”具体指什么业务？

答：维科精密的“第二增长曲线”主要指功率半导体封装零部件业务，重点涵盖半导体功率模块部件侧框、封装引线框架及桥接片等核心组件，旨在利用精密制造技术切入国内功率半导体市场。

公司目前已成功打入半导体头部供应链，并获得显著的意向性订单支撑。已与芯联集成签署《长期战略合作协议》，并与上汽英飞凌、中车半导体等达成深度合作。

32、公司在半导体领域的主要产品有哪些？

答：维科精密在半导体领域的主要产品包括半导体功率模块部件侧框（现有产品）、半导体封装引线框架（新产品）及半导体封装引线框架桥接片（新产品）。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月25日